

個人投資家様向け会社説明会

2025年9月6日（東京）

東京応化工業株式会社

TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

東証プライム(証券コード：4186)

執行役員 総務本部長 本間 裕一

tok

本日のご説明内容

1. 東京応化工業って、どんな会社？

2. 成長戦略

3. 業績・財務状況

4. 株主還元・株価推移

1. 東京応化工業って、どんな会社？

2. 成長戦略

3. 業績・財務状況

4. 株主還元・株価推移

東京応化工業 概要

世界最高水準の
「微細加工技術」 「高純度化技術」 を通じ価値創造

グローバル No.1

半導体用フォトレジスト
世界シェア*

tok
24.7%

— 経営理念 —

『自由闊達』な社風のもと
『技術のたゆまざる研鑽』にはげみ
『製品の高度化』をひたすら追求し、
すぐれた製品を供給することにより
『社会への貢献』を果たす

*EUV、ArF、KrF、g/i線用フォトレジストの2024年の見込み出荷数量ベース
(富士キメラ総研『2025 先端/注目半導体関連市場の現状と将来展望』を基に当社算出)

数字で見る 東京応化

設立
1940年

神奈川県川崎市で設立
本社は武蔵小杉に所在

連結従業員数^{*1}
1,996名

約7割が日本国内に勤務

拠点数
国内8/海外10拠点

日本/台湾/韓国/米国において
研究開発&製造&販売拠点を完備

連結売上高^{*1}
2,009億円

海外売上比率80%以上

営業利益/営業利益率^{*1}
330億円/**16.5%**

半導体材料を中心とする
高付加価値製品を提供

時価総額^{*2}
5,380億円

東証プライム市場上場企業のうち
300位前後に位置

*1 2024年12月期 *2 2025年8月6日時点

あなたの身近に **tok** のテクノロジー



あなたの身近に **tok** のテクノロジー

半導体の進化を支えるフォトレジスト

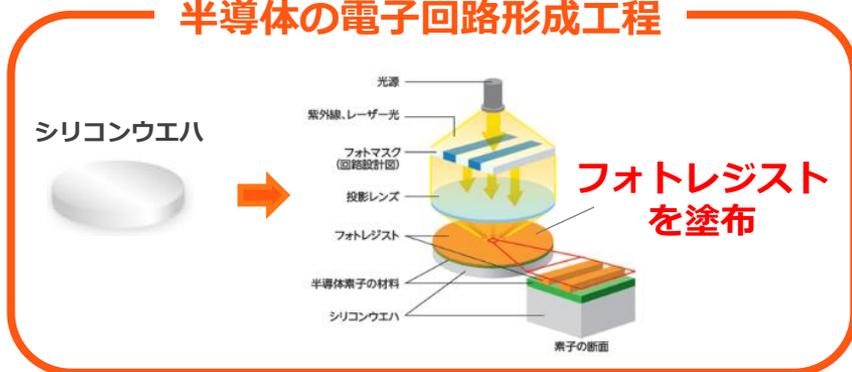


東京応化のフォトレジスト



半導体の
高性能化/小型化
低消費電力化に貢献

半導体の電子回路形成工程



安全・便利・快適な社会を実現

あなたの身近に tok のテクノロジー

フォトレジスト塗布 (★)

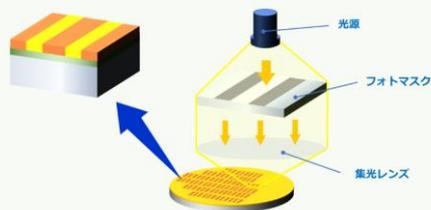
感光性材料であるフォトレジストを塗布

tok
製品使用



露光

フォトマスク (設計図) をフォトレジストに転写



現像 (★)

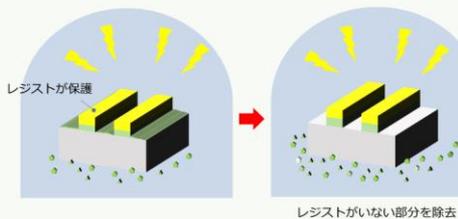
フォトレジストパターンを形成

tok
製品使用



エッチング

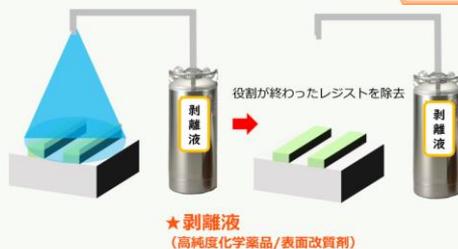
フォトレジストパターンを保護膜として、
フォトレジストのいない部分をエッチング



アッシング (★)

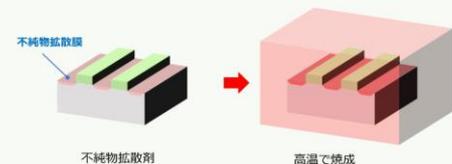
不要となったフォトレジストを除去

tok
製品使用



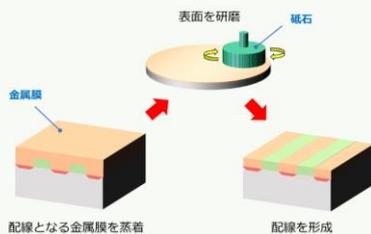
半導体領域の形成

不純物拡散剤を塗布後、高温で焼成して、
半導体領域を形成



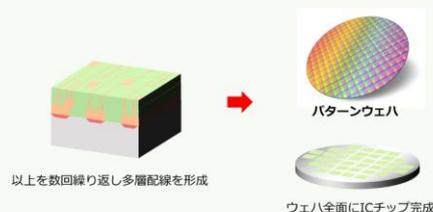
絶縁膜や配線の形成

アルミや銅で配線形成



集積回路を形成

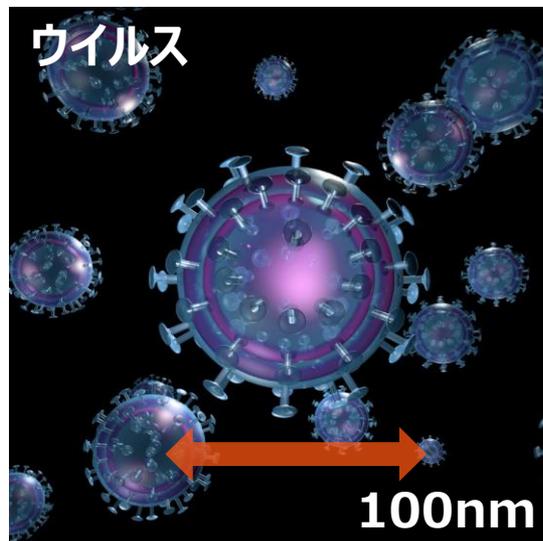
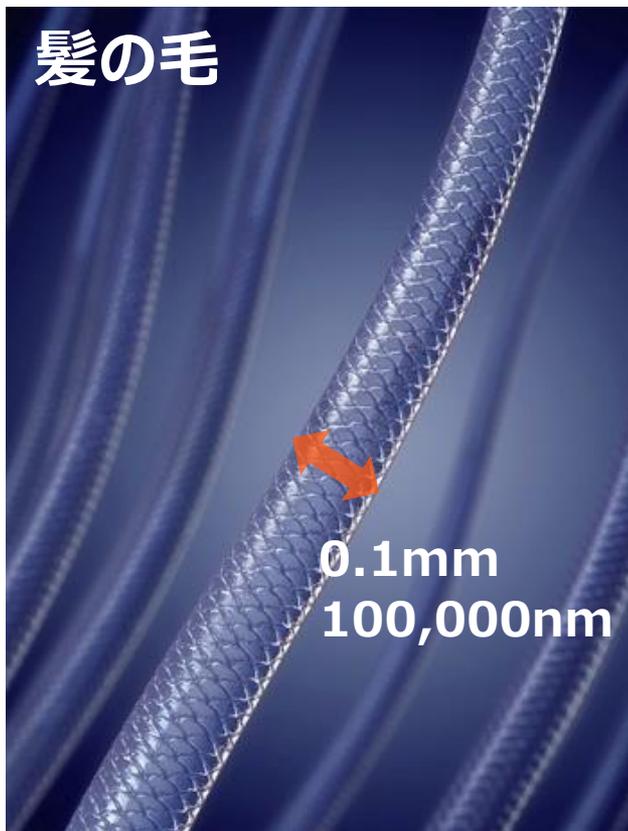
以上の工程を数回繰り返して、
多層配線の集積回路を形成する。



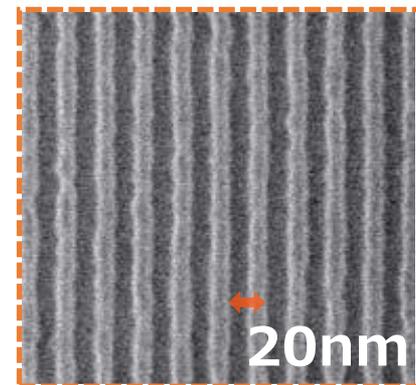
東京応化の微細加工技術

フォトレジストでナノメートルの世界を創る

大きさ比較

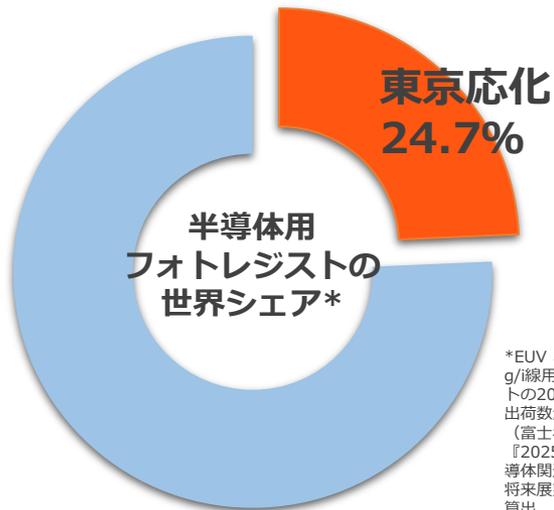


フォトレジストで形成した
微細パターン例



1 nm = 1/1,000,000 [100万分の1] mm

東京応化工業って、どんな会社？



*EUV、ArF、KrF、
g/i線用フォトレジス
トの2024年の見込み
出荷数量ベース
(富士キメラ総研
『2025 先端/注目半
導体関連市場の現状と
将来展望』を基に当社
算出)

**海外
83.8%**



① グローバル No. 1

② グローバルにビジネスを展開



2025 CONSTITUENT MSCI日本株
ESGセレクト・リーダーズ指数



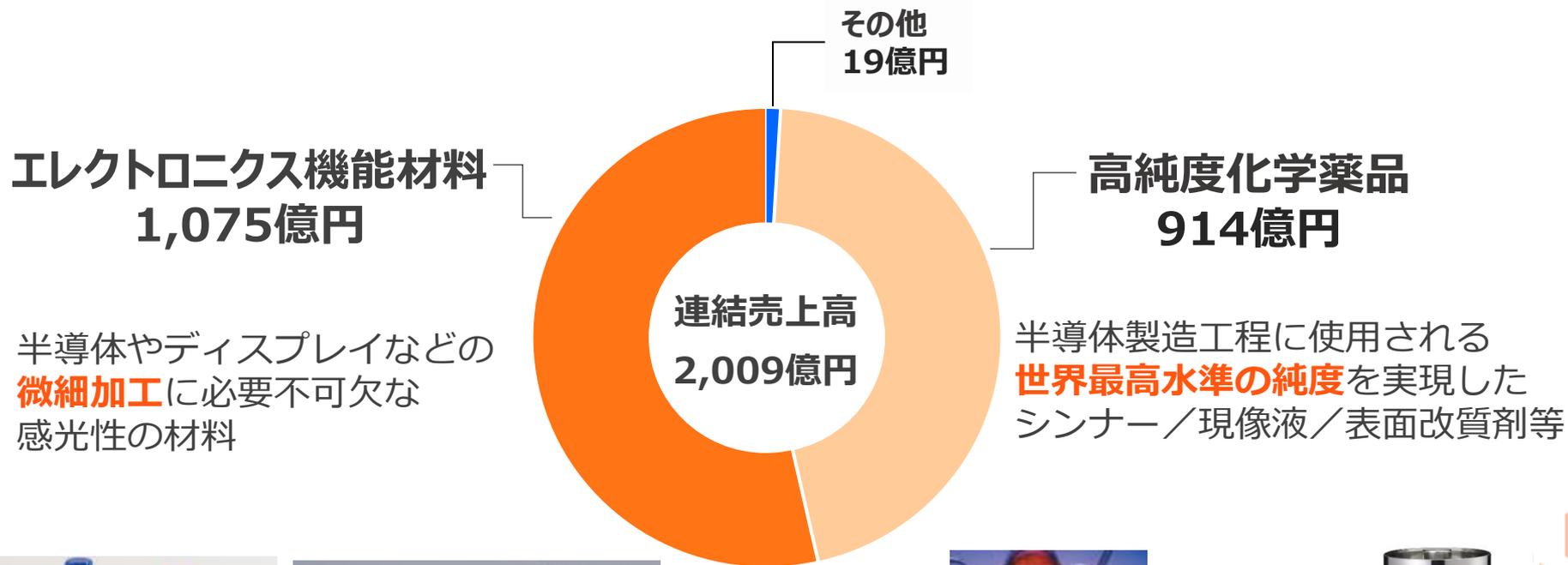
③ 『グローバルニッチトップ°企業
100』連続選出

④ 「JPX日経インデックス
400」等の構成銘柄に選定

⑤ 「2024 TSMC Excellent
Performance Award」
受賞

事業内容①：事業構成（2024年12月期）

TOKの成長を支える「微細加工技術」「高純度化技術」



事業内容②：主要製品

エレクトロニクス機能材料

○半導体前工程用フォトレジスト
(EUV/ArF/KrF/i/g)

○半導体後工程関連材料
(パッケージ材料・MEMS材料・WHS関連材料)

○ディスプレイ材料・その他



高純度化学薬品

シンナー
現像液
表面改質剤等

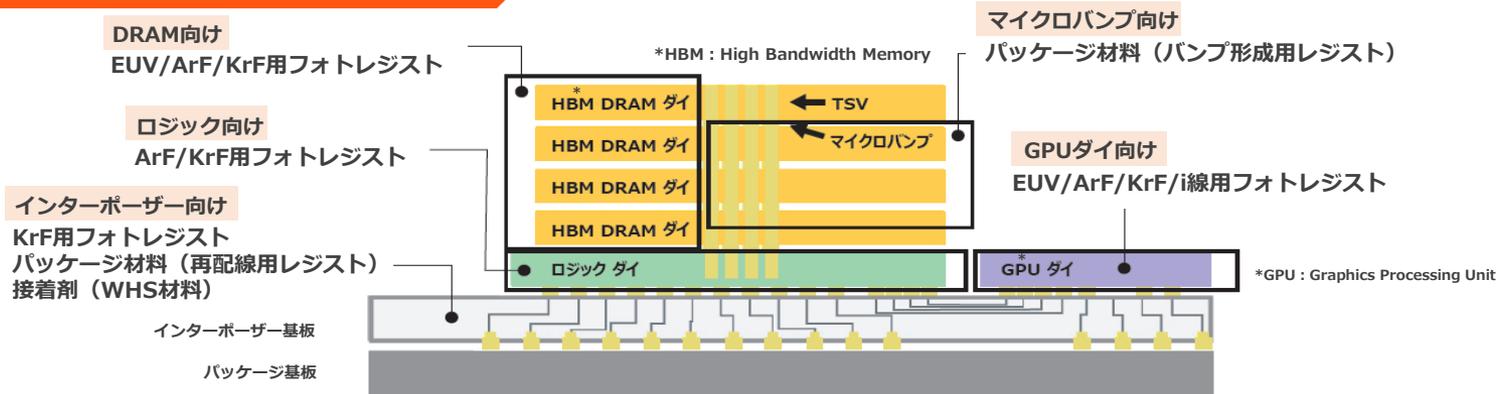


<特徴>

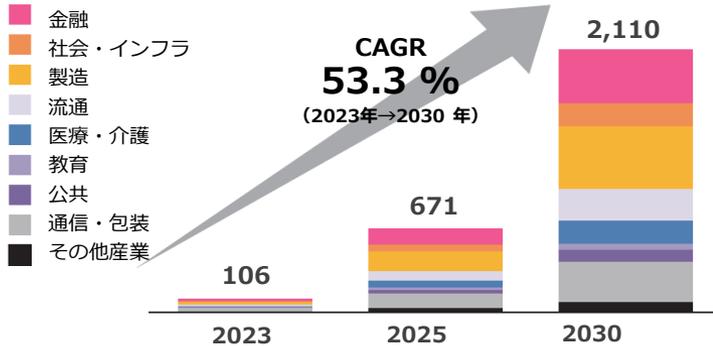
- ✓ 半導体製造前工程用フォトレジストをフルラインナップ[®]で提供
- ✓ 高純度・高品質な製品を安定的に提供

生成AI需要の増加によるTOK製品の成長

生成AI用GPUとTOK製品の使用例



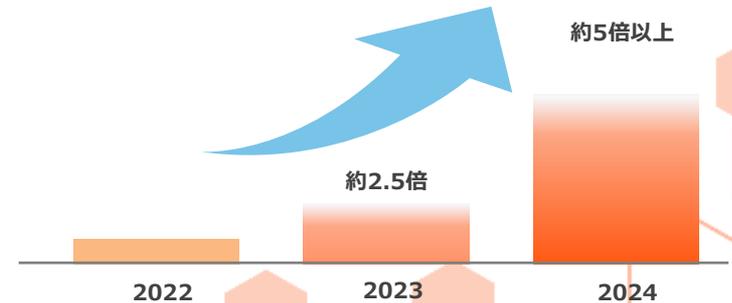
生成AI市場の成長予測 (単位：億ドル)



出典：電子情報技術産業協会「電子情報産業の世界生産見通し」(2023年12月)



HBM向けバンプ形成用レジスト 売上成長 (2022年比)



事業戦略：新規事業

100年企業を見据えた 新規事業の創出

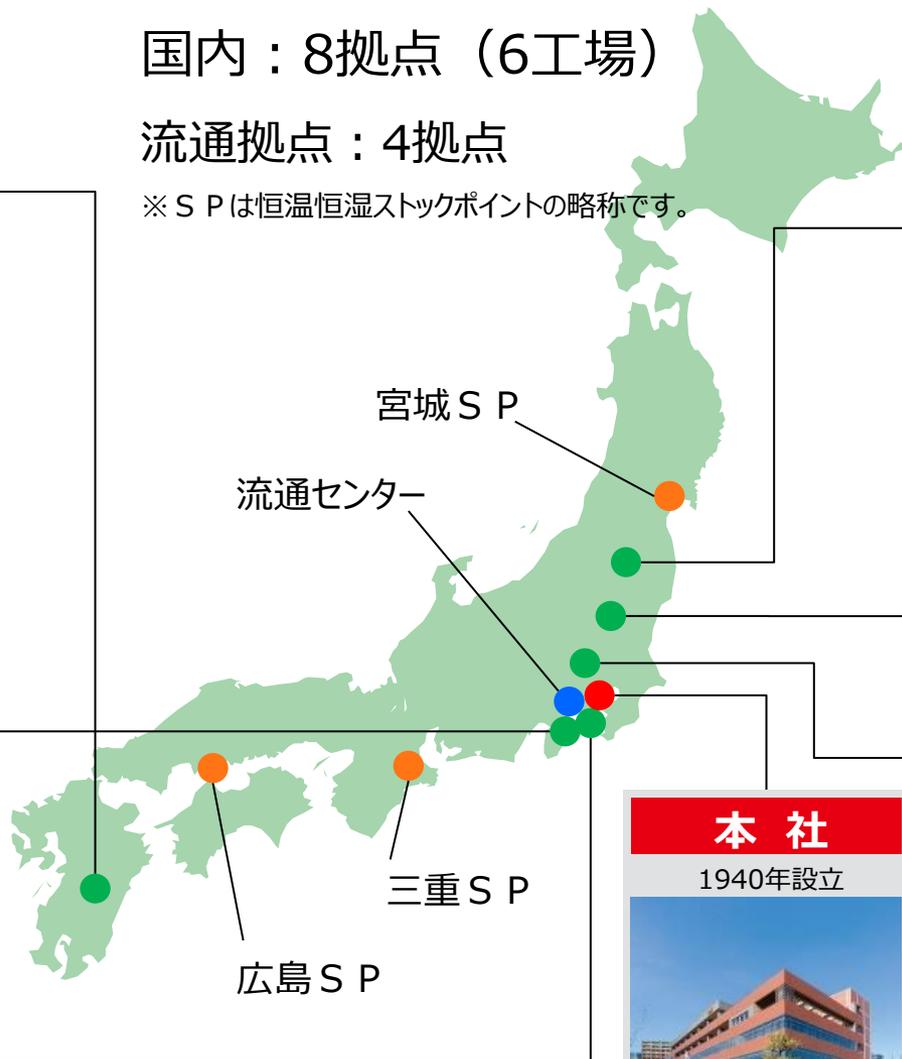


東京応化 国内拠点

国内：8拠点（6工場）

流通拠点：4拠点

※ S P は恒温恒湿ストックポイントの略称です。



阿蘇工場

1984年設立



阿蘇くまもとサイト

2024年竣工



御殿場工場

1987年設立



TOK
技術革新センター

1967年設立



郡山工場

1994年設立



宇都宮工場

1981年設立



熊谷工場

1983年設立



本社

1940年設立



東京応化 海外拠点

海外：5社（4工場）

tok 東京応化工業(株)（本社）

ヨーロッパ支社

上海帝奥科電子科技有限公司
本社（中国）

2021年設立

シンガポール事務所

micro resist technology GmbH
本社／ベルリン工場(ドイツ)

2025年子会社化



台湾東應化社

本社(新竹市)／銅鑼工場(苗栗県)

1998年設立



TOK先端材料社
本社／仁川工場(韓国)

2012年設立



TOKアメリカ社
本社／オレゴン工場（オレゴン州）
販売事務所（カリフォルニア州）
TOKCAZ, LLC(アリゾナ州)

1993年設立



顧客密着戦略のさらなる進化

2025年2月 ドイツの研究開発型化学メーカーを完全子会社化

欧州における顧客サポート体制を強化 MRT社との技術の融合により製品ポートフォリオを拡充

micro resist technology GmbH (MRT社)

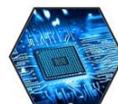
設立：1993年 所在地：ベルリン、ドイツ

事業内容：

感光性フォトレジスト、ハイブリッドポリマー、
ナノインプリント材料の開発・製造・販売

事業領域

Consumer Electronics
Automotive / Mobility



Micro & Opto-
electronics

Lighting &
Telecommunication
Technology



Sensor
Technology

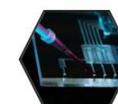
Health Care / Medical



Micro-optics
& Photonics



Display &
Immersive Tech.



Microfluidics
& Biosensors



1. 東京応化工業って、どんな会社？

2. 成長戦略

3. 業績・財務状況

4. 株主還元・株価推移

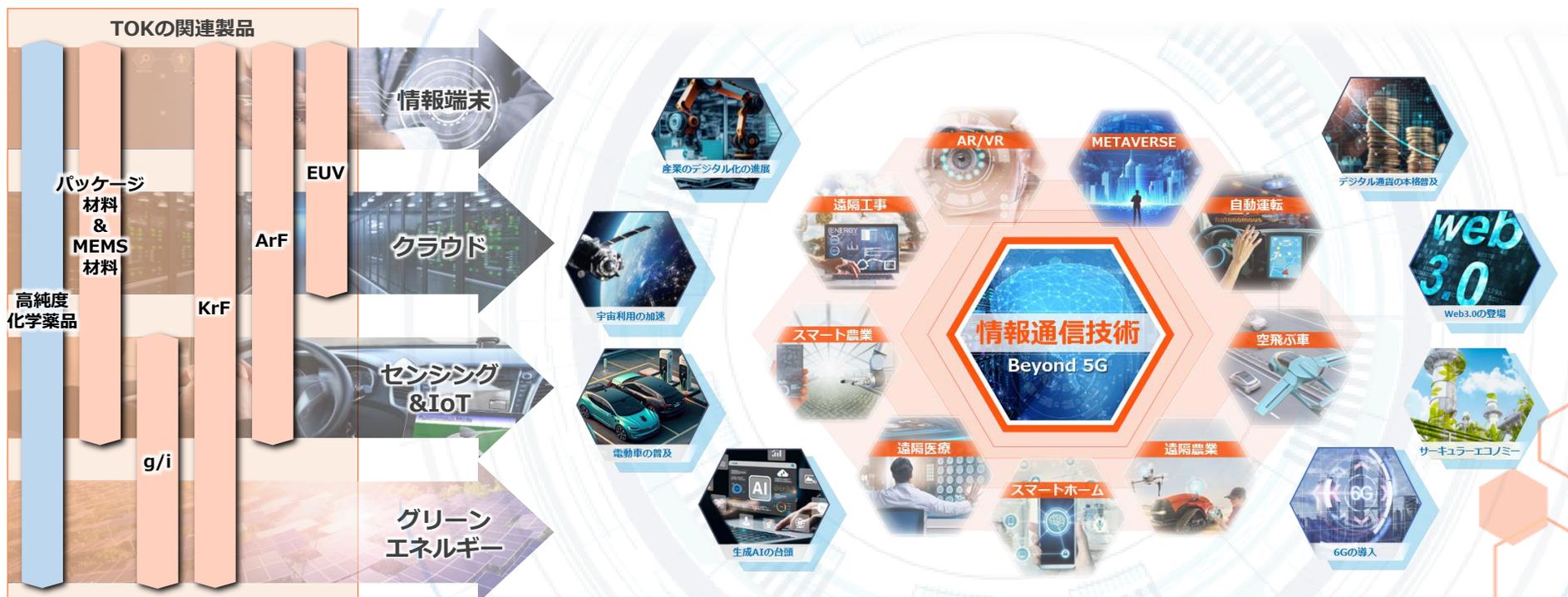
東京応化を取り巻く環境_2030年の社会

デジタル技術の急速な発達と新たな展望



2030年の社会 ~tok Vision 2030~

4つの分野で豊かな未来の実現に貢献 更なる成長を目指す



tok Vision 2030

経営ビジョン

豊かな未来、社会の期待に化学で応える
“The e-Material Global Company™”

2030年のありたい姿

定性側面

- 顧客が感動するイノベーションを提供する
- 世界のステークホルダーから信頼される
- 高い技術力を育成し続け、グローバルで存在感を示す
- SDGsに貢献することを意識し、企業価値を持続的に向上させる
- 皆が生き活きと誇りをもって働ける

定量側面

	2024年度		tok中期計画2027 2027年度目標		2030年度
売上高	2,009億円	➤	2,700億円	➤	<u>3,500億円</u>
EBITDA	414億円	➤	610億円	➤	<u>770億円</u>
ROE	11.8%	➤	13.0%	➤	<u>13.0%</u>

高品質製品の安定供給を継続

2025年8月 韓国にて新工場（平澤工場）の建設を開始

生産能力および品質を向上
既存の仁川工場との相乗効果の最大化を図る

TOK先端材料株式会社にて進行中の設備投資

平澤工場
(京畿道平澤市)

2025年8月 **新製造棟着工**
投資金額：約120億円
生産品目：高純度化学薬品
→2027年下期 稼働予定



エレクトロニクス機能材料の供給能力増強投資も検討中

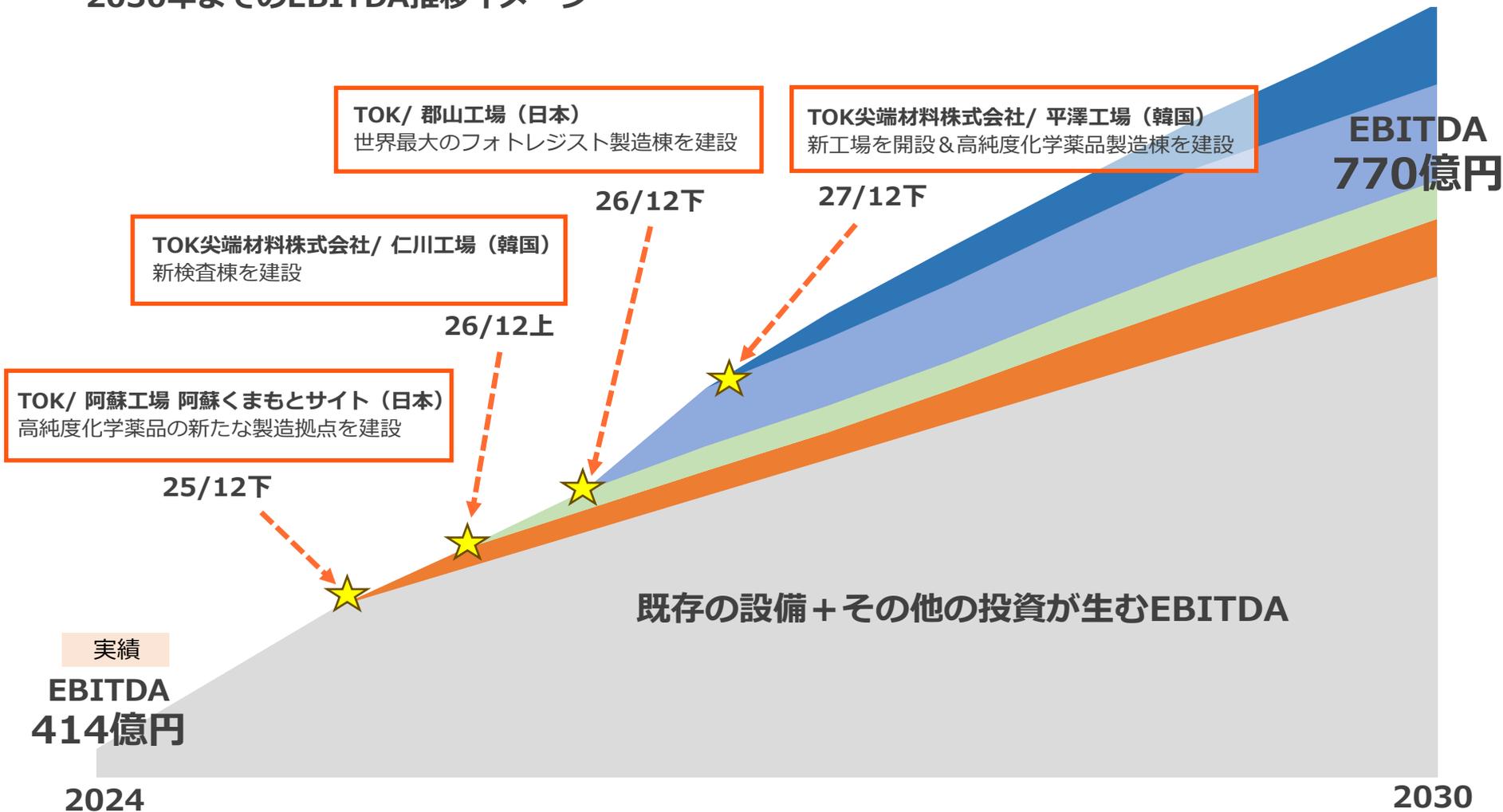
仁川工場

2025年3月 **新検査棟竣工**
投資金額：約70億円
→2026年上期 稼働予定



製造資本の強化によるキャッシュ創出力拡大

2030年までのEBITDA推移イメージ



「稼ぐ力」を高めるための4つの人財戦略

多様性に富んだ母集団の形成

人財育成

DE&Iの推進

エンゲージメントの向上

施策例

- 役員報酬制度の評価軸に従業員エンゲージメント指標を導入
- 表彰制度 (TOK SHINKA AWARD) グローバル化
- 東京応化グローバル社員持株会制度を導入
- 60歳から65歳へ定年延長(現役時の給与水準を維持)
- リカレント教育 DX・デジタル活用、一人当たりの教育研修費の増加

2024年実績：**12.9万円** (産労総合研究所「2024年度教育研修費用の実態調査」における上場企業等169社平均：3.4万円)

- 3年連続で5%超の賃上げを実施 (2022～2024年)

1. 東京応化工業って、どんな会社？

2. 成長戦略

3. 業績・財務状況

4. 株主還元・株価推移

業績概要

(百万円、%)

	2024/6	2025/6				
			増減	増減率(%)	期初計画	進捗率(%)
売上高	94,736	111,623	+16,887	+17.8	106,600	104.7
エレクトロニクス機能材料	51,360	58,149	+6,789	+13.2	56,100	103.7
高純度化学薬品	42,475	51,985	+9,509	+22.4	49,100	105.9
その他	900	1,488	+588	+65.3	1,400	106.3
営業利益	13,443	19,846	+6,403	+47.6	17,500	113.4
経常利益	14,110	20,381	+6,271	+44.4	17,900	113.9
親会社株主に 帰属する中間純利益	9,143	13,619	+4,476	+49.0	11,400	119.5
EBITDA	17,570	23,994	+6,423	+36.6	21,800	110.1

期中平均為替 (USドル) : 151.5円/ドル (2024/6) ⇒ 147.0円/ドル (2025/6)

- 売上高 : スマートフォンの需要が低調に推移したものの、生成AI関連向け需要が好調に推移したことに加え、パソコンの買い替え需要が堅調に推移したことにより前年同期比+17.8%の増収。
- 営業利益 : 経費増加があったものの増収により、前年同期比+47.6%の増益。
- 中間純利益 : 営業利益の増加に加え、装置事業譲渡に伴う特別利益の計上により、前年同期比+49.0%の増益。

業績予想概要 (通期)

(百万円、%)

	2024/12	2025/12				
			増減	増減率(%)	期初計画	期初計画比(%)
売上高	200,966	227,000	+26,033	+13.0	222,000	+2.3
エレクトロニクス機能材料	107,515	119,800	+12,284	+11.4	116,700	+2.7
高純度化学薬品	91,476	104,300	+12,823	+14.0	102,600	+1.7
その他	1,974	2,900	+925	+46.9	2,700	+7.4
営業利益	33,090	40,000	+6,909	+20.9	37,300	+7.2
経常利益	34,554	41,000	+6,445	+18.7	38,200	+7.3
親会社株主に 帰属する当期純利益	22,683	26,500	+3,816	+16.8	24,600	+7.7
EBITDA	41,424	48,900	+7,476	+18.0	46,800	+4.4
ROE	11.8	12.7	+0.9	-	11.8	+0.9

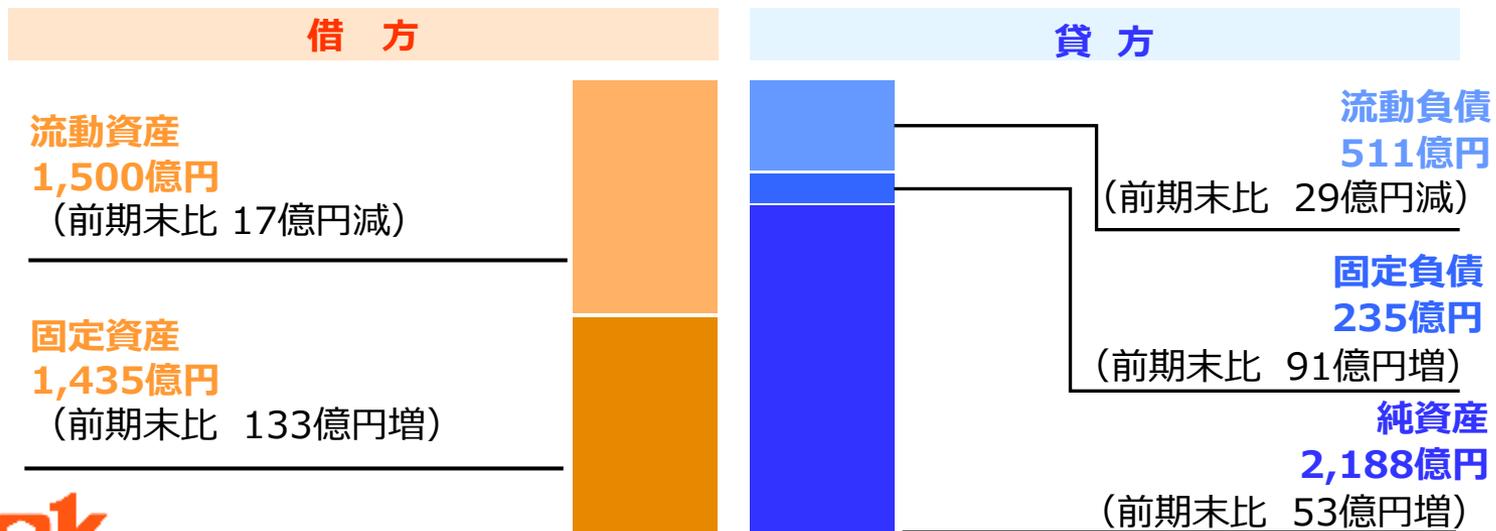
期中平均為替 (USドル) : 150.8円/ドル (2024/12) ⇒ 140.0円/ドル (2025/12下期)

- 売上高 : 生成AI関連の需要増加および顧客の新工場稼働開始等により、前年比+13.0%を予想。
- 営業利益 : 経費の増加および為替の影響により利益が伸び悩むものの売上高の増加により、前年比+20.9%の増益を予想。
- 当期純利益 : 営業利益の増加により、前年比+16.8%の増益を予想。

財務状況 (2025年6月30日現在)

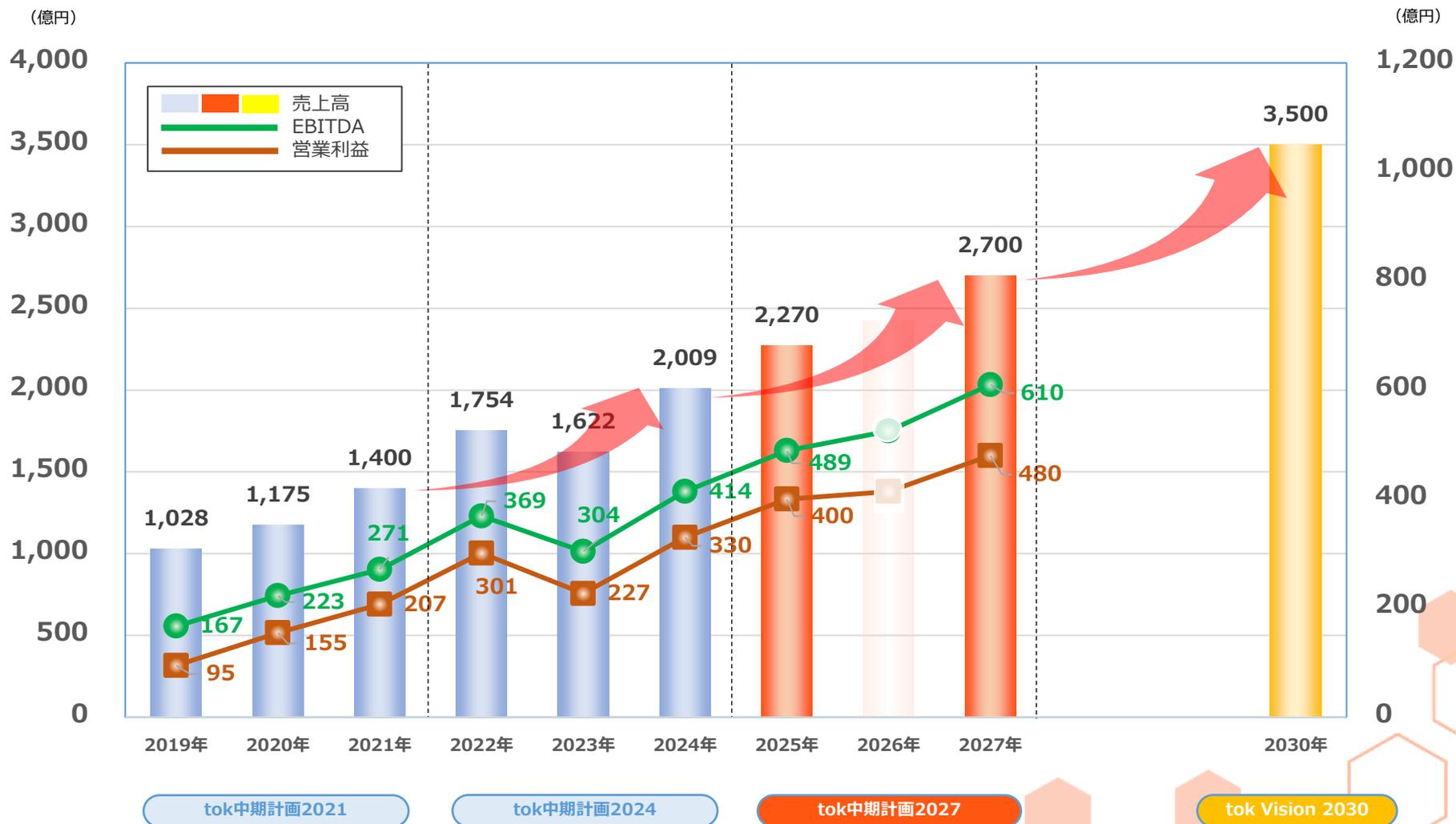
長期戦略に基づく、投資計画、株主還元が実行可能

総資産	2,935億円
純資産	2,188億円
自己資本比率	70.8%



業績の推移

2025年度12月期は過去最高の売上を予想



1. 東京応化工業って、どんな会社？

2. 成長戦略

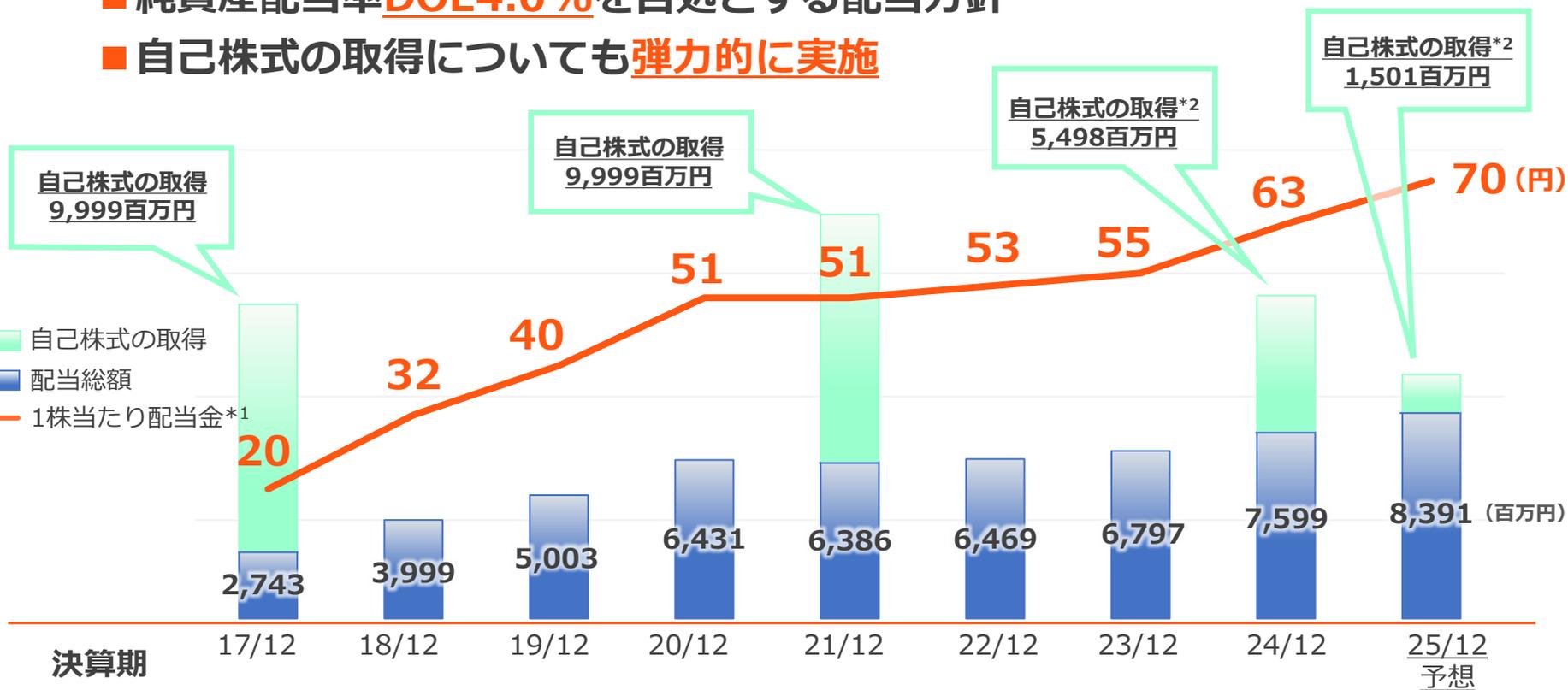
3. 業績・財務状況

4. 株主還元・株価推移

株主還元

<tok Vision 2030を実現する強固な経営基盤の構築>

- 純資産配当率 **DOE4.0%** を目処とする配当方針
- 自己株式の取得についても **弾力的に実施**



中間配当	10円	12円	20円	20円	20円	26円	27円	29円	35円
期末配当	10円	20円	20円	21円	31円	27円	28円	34円	35円予想
特別配当				10円					

配当政策
数値基準

tok中期計画2018
～配当性向40%以上～

tok中期計画2021
～DOE3.5%を基準～

tok中期計画2024
～DOE4.0%を基準～

tok中期計画2027
～DOE4.0%を基準～

tok

2024年1月1日付(効力発生日)で1株を3株に株式分割を実施

*1 2023年12月期以前は株式分割後換算1円以下は切り捨てて算出しています

*2 取得期間：2024年11月13日～2025年1月30日

株式の概況

株価チャート

(Yahoo!ファイナンスより引用)



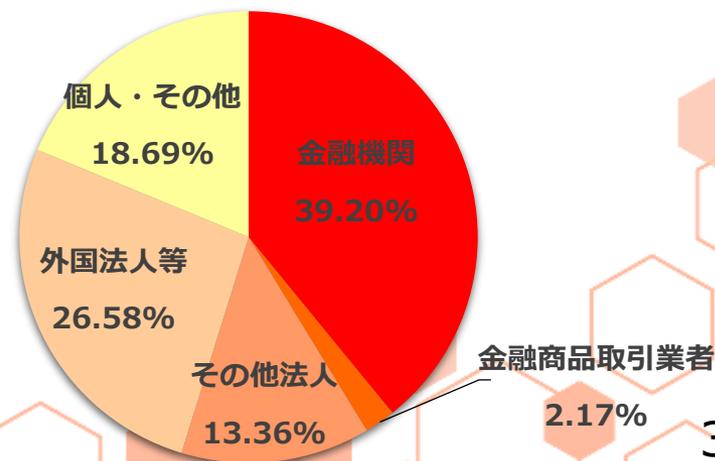
発行可能株式総数 500,000,000株

発行済株式の総数 127,800,000株

株主数 22,061名

(2025年6月30日現在)

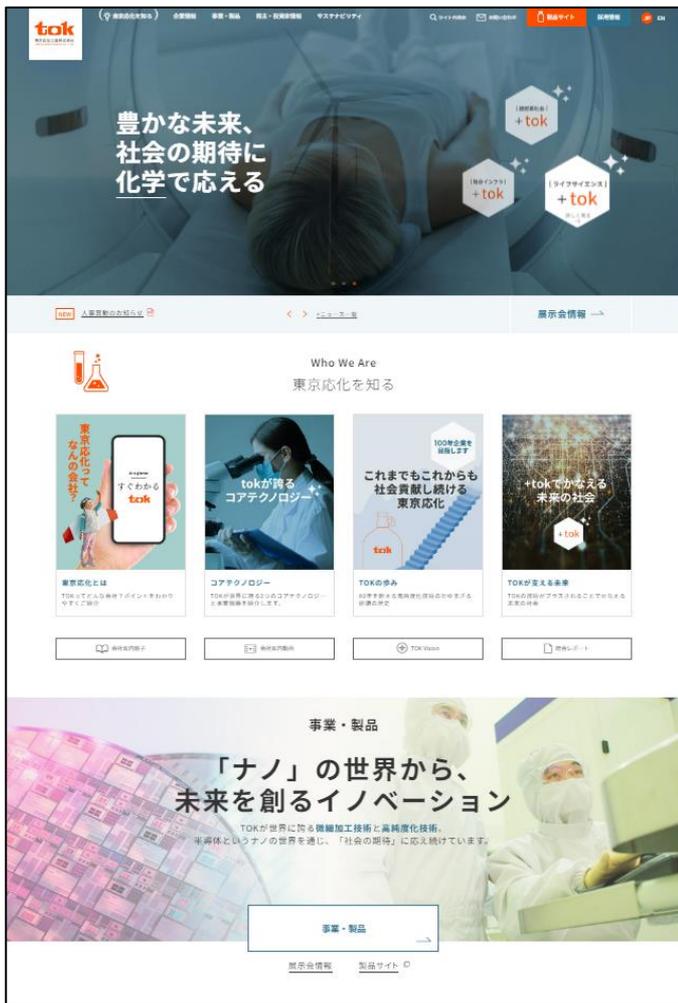
所有者別株式分布状況



tok のホームページ

最新情報を随時更新しています

www.tok.co.jp



多彩な切り口で製品を紹介



決算説明会動画も配信中



ご清聴ありがとうございました。

* 本資料は投資勧誘の目的のための資料ではありません。また、将来に亘る部分につきましては、予想に基づくものであり、確約や保証を与えるものではありません。当然、予想と違う結果となることがあることを十分にご認識の上ご活用ください。

IR情報メール配信サービス

当社の最新IR情報をメール配信中 ↓ご登録はこちらから（無料）



<https://rims.tr.mufg.jp/?sn=4186>



※RIMSNETは、三菱UFJ信託銀行証券代行部が運営するIR情報メール配信サービスです

東京応化のフォトレジスト

半導体の微細化において、多様な回路線幅に対応する東京応化のフォトレジスト

	i線用フォトレジスト	KrF用フォトレジスト	ArF用フォトレジスト	EUV用フォトレジスト
				
リソグラフィ用光源	i線	KrF(フッ化クリプトン) エキシマレーザー	ArF(フッ化アルゴン) エキシマレーザー	EUV(極紫外線)
光源の波長	365nm(i線)	248nm	193nm	13.5nm
	長い			短い
半導体の回路線幅*	350nm>~≥250nm	250nm>~≥130nm	130nm>~≥10nm	10nm>~
	広い			狭い
主なアプリケーション/ 最終製品等	自動車向けパワー半導体 センサー LED等	普及型スマートフォン 高性能サーバー ゲーム機等	最新型スマートフォン ウェアラブル端末 高性能サーバー等	次世代サーバー 次世代スーパーコンピュータ 次世代通信システム等

* 主要レンジのみ表示



あなたの身近に tok のテクノロジー

半導体製造前工程フロー ※ (★) 当社製品使用工程

フォトレジスト塗布 (★)

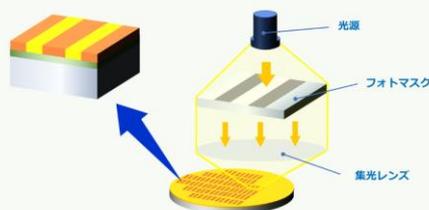
感光性材料であるフォトレジストを塗布

tok
製品使用



露光

フォトマスク (設計図) をフォトレジストに転写



現像 (★)

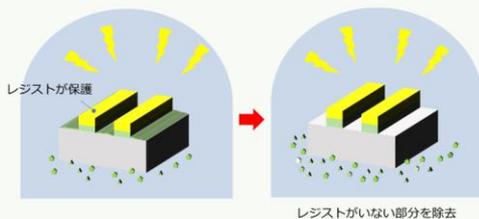
フォトレジストパターンを形成

tok
製品使用



エッチング

フォトレジストパターンを保護膜として、
フォトレジストのない部分をエッチング



アッシング (★)

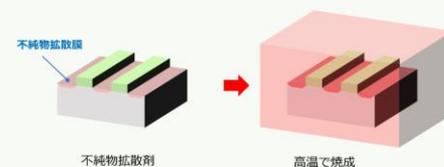
不要となったフォトレジストを除去

tok
製品使用



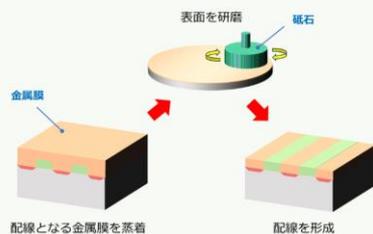
半導体領域の形成

不純物拡散剤を塗布後、高温で焼成して、
半導体領域を形成



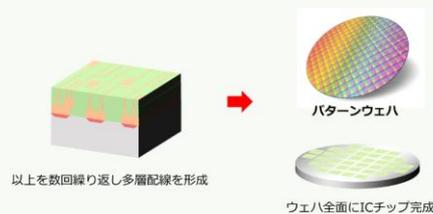
絶縁膜や配線の形成

アルミや銅で配線形成



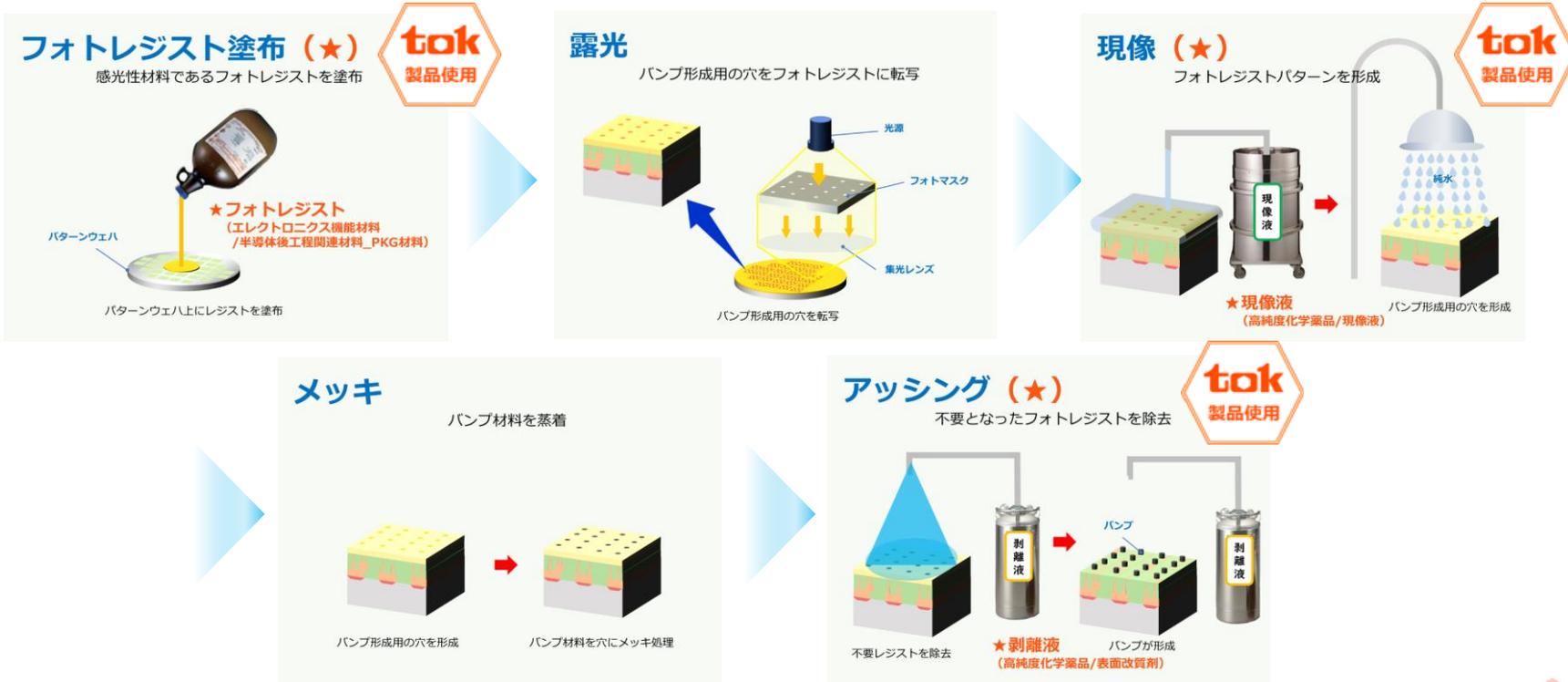
集積回路を形成

以上の工程を数回繰り返して、
多層配線の集積回路を形成する。



あなたの身近に tok のテクノロジー

半導体製造後工程フロー ※ (★) 当社製品使用工程



あなたの身近に tok のテクノロジー

半導体製造後工程フロー ※ (★) 当社製品使用工程

接着剤、剥離層塗布 (★)

サポート板貼付け、剥離用材料を塗布

パターンウェハに接着剤を塗布 → ガラスウェハにRLを塗布

★接着剤 (エレクトロニクス機能材料 / 半導体後工程関連材料_WHS材料)

★剥離剤 (RL) (エレクトロニクス機能材料 / 半導体後工程関連材料_WHS材料)

tok 製品使用

仮貼合せ

デバイスウェハとサポート板を貼付け

ガラスウェハ

パターンウェハ

お互い成膜面を貼り合わせる

バックグラインド

ウェハの裏面を削りウェハを薄化する

反転

砥石

パターンウェハの裏面を研磨し薄化する

封止剤塗布

ウェハの裏面に封止剤を塗布

パターンウェハの裏面に封止剤塗布

ガラス面の上にダイシングフレームに装着

サポート板剥離

ウェハからサポート版を剥離

レーザーユニット

レーザーを照射して剥離層を破壊

ガラス (サポート板) を剥離

洗浄 (★)

ウェハ表面の接着剤を除去

シンナー

シンナー (エレクトロニクス機能材料 / 半導体後工程関連材料_WHS材料)

接着剤を除去

tok 製品使用

ダイシング

ICチップの切出し

ICチップ一つずつ切り出し

フリップボンディング

プリント基板に貼合わせて

ICチップを反転

プリント基板に装着